

2-1-2-23 SR 面マジックインク汚れ／SR 表面的墨水玷污／ Solder resist surface contaminated with marker pen ink

【特徴】 様々な色のマジックインクが S R の表面に付着している状態の欠陥

【特征】 各種色の墨水附着在 SR 表面的缺陷。

【Characteristics】 The solder resist surface is stained with marker pen ink of various colours.

【原因・判断ポイント・発生工程】 識別用に使われる様々な色のマジックインクを誤って S R の表面に接触させたことにより出来たもの（S R 塗布乾燥後工程）

【原因、判断要点、发生工序】 因为错误，用不同颜色的墨水做标记时接触 SR 表面所发生的（SR 烘干后工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 Caused by careless contact of various coloured marker pen used for identification to the solder resist surface. (After solder resist application process)



【コメント】
顕微鏡倍率 × 50

【注釋】
显微镜倍率 × 50

【Comments】
Magnification: ×50



【コメント】
顕微鏡倍率 × 25

【注釋】
显微镜倍率 × 25

【Comments】
Magnification: ×25

2-1-2-24 FPC 表面異物付着／FPC 表面附着杂物／ Foreign objects on FPC surface

【特徴】 様々な異物が F P C の表面に付着している状態の欠陥

【特征】 各種杂物附着在 FPC 表面的缺陷。

【Characteristics】 Various kinds of foreign objects are attached to the surface of an FPC.

【原因・判断ポイント・発生工程】 様々な異物が F P C の製造過程で F P C の表面に付着し、圧着されて出来たもの（カバーレイ仮貼り工程後の全工程）

【原因、判断要点、发生工序】 在 FPC 制造过程，表面附着并压合各种杂物所引起的（覆盖层临时压合后的全过程）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 Various kinds of foreign objects are attached and adhered by pressure to the surface of an FPC during fabrication. (All the processes after coverlay application)



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
FPC
显微镜倍率 ×

【Comments】
FPC
Magnification: ×



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
FPC
显微镜倍率 ×

【Comments】
FPC
Magnification: ×